

LIVE配信
アーカイブ配信

7日間何度でも
視聴可能

【中級編】 電子機器における防水設計技術

◆日時：2025年2月4日(火) 13:00~16:30 ◆受講料：(消費税等込) 1名:38,500円
 ◆会場：WEB受講のみ (Zoomシステム) 同一セミナー 同一企業同時複数人数申込の場合 1名:33,000円
 ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可) ◆受講資料：PDF資料(受講料に含)
 ※当日の出席・欠席の有無は問いません

**防水構造・設計、防水部品・規格、防水計算・CAEなどについて、
豊富な経験に基づき、具体事例を交えながら
分かりやすく解説する特別セミナー !!**

【講師の言葉】

スマートフォンを中心とした電子機器への防水機能付与は一般的になりつつあります。その恩恵は電子基板の保護やその故障率の低下など製品品質、品位の向上につながります。

求められる防水規格・試験は製品毎で異なりますが、防水構造の基本はそれほど変わるわけではありません。昨今は、IoT機器が身の回りに溢れてきました。スマートフォンも構造が成熟してきた時に防水技術にチャレンジし今では全機種が防水端末です。

これからのIoTや様々な機器は防水構造になっていくでしょう。だからこそ防水構造を設計基準として大別していく時期になってきました。中級編では各設計をより紐解いていきます。

【受講形式】 WEB受講のみ ※本セミナーは、Zoomシステム利用によるオンライン配信となります。

【受講対象】 構造設計既に手がけている設計者
防水構造にお悩みの設計者
会社として防水構造をしっかりと構築したい方々

【予備知識】 IP規格の基礎がわかっている程度

【習得知識】 1) 防水構造 2) 防水設計 3) 防水部品・規格 4) 防水計算・CAE など

◆セミナーお申込要領

- 申し込み方法
 - ・弊社ホームページの申込欄又は、FAXかE-mailにてお申し込みください。
 - ・折り返し、受講票、請求書、会場案内図をお送り致します。
 - ・開催日の8日前以内のキャンセルは、お受け致しかねますので、必要に応じ代理の方のご出席をお願いします。
 - ・開催日の8日前以内のキャンセルの場合、受講料の全額を申し受けます。

- お支払い方法
 - 受講料は原則として開催前日までにお支払い願います。
 - 経理上、受講料のお支払いがセミナー開催後になる場合は、お支払日をお知らせ願います。
 - 振り込み手数料は御社の御負担にてお願いします。

●申込先 

〒108-0014 東京都港区芝4-5-1 11-5F
 TEL:03-6435-1138
 FAX:03-6435-3685
 E-mail:th@thplan.com

検索 TH企画 → サイト内検索 0204 (開催日)

詳細、その他のセミナーは、ホームページをご覧ください。

<https://www.thplan.com/>

◆ プログラム ◆

【講師】 神上コーポレーション株式会社 代表取締役 鈴木 崇司 先生
 共同技研化学、富士通を経て現在に至る

1. 会社紹介
2. 防水構造設計
 - 2-1 筐体設計
 - 2-2 キャップ、カバー設計
 - 2-3 防水膜/音響部
 - 2-4 スイッチ
 - 2-5 防水モジュール(USB、スピーカーなど)
3. 止水部品設計
 - 3-1 ガasket、パッキン(一体型、ゲル使用)
 - 3-2 Oリング 参照値と実使用
 - 3-3 防水両面テープ/接着剤
 - 3-4 防水ネジ
4. 放熱設計
 - 4-1 なぜ放熱を考えるのか
 - 4-2 熱伝導
 - 4-3 低温火傷
 - 4-4 放熱材料
5. 防水計算&CAE
 - 5-1 ガasket/パッキン止水と隙間の確認
 - 5-2 両面テープ 濡れ性
 - 5-3 スイッチの押し感(クリアランス⇄干涉)
 - 5-4 放熱シミュレーション
6. リーク試験
 - 6-1 閾値の設定
 - 6-2 原因解明と対策実施例
 - 6-3 FUKUDA
7. 技術紹介・まとめ
 - 7-1 TIM
 - 7-2 撥水
 - 7-3 設計支援

質疑・応答

●申込書・2025年2月4日(火)「【中級編】電子機器における防水設計技術」

会社名	〒	住所
TEL		FAX
正式所属		正式所属
受講者名		受講者名
E-mail		E-mail
振り込み 予定		通信欄